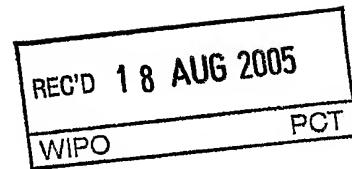


# 特許協力条約

PCT



特許性に関する国際予備報告（特許協力条約第二章）

（法第 12 条、法施行規則第 56 条）  
〔PCT36 条及び PCT 規則 70〕

出願人又は代理人 の書類記号	TU04-1109W01		今後の手続きについては、様式 PCT / IPEA / 416 を参照すること。
国際出願番号	国際出願日 (日.月.年) 30.11.2004	優先日 (日.月.年) 25.12.2003	
国際特許分類 (IPC) Int.Cl. <sup>7</sup> C23C14/34, C22C9/00, 9/06			
出願人（氏名又は名称） 株式会社 日鉄マテリアルズ			

1. この報告書は、PCT35 条に基づきこの国際予備審査機関で作成された国際予備審査報告である。  
法施行規則第 57 条 (PCT36 条) の規定に従い送付する。

2. この国際予備審査報告は、この表紙を含めて全部で 3 ページからなる。

3. この報告には次の附属物件も添付されている。

a.  附属書類は全部で 1 ページである。

補正されて、この報告の基礎とされた及び／又はこの国際予備審査機関が認めた訂正を含む明細書、請求の範囲及び／又は図面の用紙 (PCT 規則 70.16 及び実施細則第 607 号参照)

第 I 欄 4. 及び補充欄に示したように、出願時における国際出願の開示の範囲を超えた補正を含むものとこの国際予備審査機関が認定した差替え用紙

b.  電子媒体は全部で \_\_\_\_\_ (電子媒体の種類、数を示す)。  
配列表に関する補充欄に示すように、コンピュータ読み取り可能な形式による配列表又は配列表に関するテーブルを含む。 (実施細則第 802 号参照)

4. この国際予備審査報告は、次の内容を含む。

第 I 欄 国際予備審査報告の基礎  
 第 II 欄 優先権  
 第 III 欄 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての国際予備審査報告の不作成  
 第 IV 欄 発明の單一性の欠如  
 第 V 欄 PCT35 条(2)に規定する新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解、それを裏付けるための文献及び説明  
 第 VI 欄 ある種の引用文献  
 第 VII 欄 国際出願の不備  
 第 VIII 欄 国際出願に対する意見

国際予備審査の請求書を受理した日 10.05.2005	国際予備審査報告を作成した日 01.08.2005
名称及びあて先 日本国特許庁 (IPEA / JP) 郵便番号 100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目 4 番 3 号	特許庁審査官 (権限のある職員) 真々田 忠博 電話番号 03-3581-1101 内線 3416

## 第I欄 報告の基礎

1. この国際予備審査報告は、下記に示す場合を除くほか、国際出願の言語を基礎とした。

この報告は、\_\_\_\_\_語による翻訳文を基礎とした。  
それは、次の目的で提出された翻訳文の言語である。

PCT規則12.3及び23.1(b)にいう国際調査

PCT規則12.4にいう国際公開

PCT規則55.2又は55.3にいう国際予備審査

2. この報告は下記の出願書類を基礎とした。（法第6条（PCT14条）の規定に基づく命令に応答するために提出された差替え用紙は、この報告において「出願時」とし、この報告に添付していない。）

出願時の国際出願書類

明細書

第 1-10 ページ、出願時に提出されたもの  
第 \_\_\_\_\_ ページ\*、\_\_\_\_\_ 付けで国際予備審査機関が受理したもの  
第 \_\_\_\_\_ ページ\*、\_\_\_\_\_ 付けで国際予備審査機関が受理したもの

請求の範囲

第 2, 4-6 項、出願時に提出されたもの  
第 1 項\*、PCT19条の規定に基づき補正されたもの  
第 \_\_\_\_\_ 項\*、\_\_\_\_\_ 付けで国際予備審査機関が受理したもの  
第 \_\_\_\_\_ 項\*、\_\_\_\_\_ 付けで国際予備審査機関が受理したもの

図面

第 \_\_\_\_\_ ページ/図、出願時に提出されたもの  
第 \_\_\_\_\_ ページ/図\*、\_\_\_\_\_ 付けで国際予備審査機関が受理したもの  
第 \_\_\_\_\_ ページ/図\*、\_\_\_\_\_ 付けで国際予備審査機関が受理したもの

配列表又は関連するテーブル

配列表に関する補充欄を参照すること。

3.  補正により、下記の書類が削除された。

明細書 第 \_\_\_\_\_ ページ  
 請求の範囲 第 3 項  
 図面 第 \_\_\_\_\_ ページ/図  
 配列表（具体的に記載すること） \_\_\_\_\_  
 配列表に関連するテーブル（具体的に記載すること） \_\_\_\_\_

4.  この報告は、補充欄に示したように、この報告に添付されかつ以下に示した補正が出願時における開示の範囲を超えてされたものと認められるので、その補正がされなかつたものとして作成した。（PCT規則70.2(c)）

明細書 第 \_\_\_\_\_ ページ  
 請求の範囲 第 \_\_\_\_\_ 項  
 図面 第 \_\_\_\_\_ ページ/図  
 配列表（具体的に記載すること） \_\_\_\_\_  
 配列表に関連するテーブル（具体的に記載すること） \_\_\_\_\_

\* 4. に該当する場合、その用紙に "superseded" と記入されることがある。

第V欄 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての法第12条（PCT35条(2)）に定める見解、  
それを裏付ける文献及び説明

## 1. 見解

新規性 (N)	請求の範囲 <u>1, 2, 4-6</u>	有
	請求の範囲 _____	無
進歩性 (I S)	請求の範囲 <u>1, 2, 4-6</u>	有
	請求の範囲 _____	無
産業上の利用可能性 (I A)	請求の範囲 <u>1, 2, 4-6</u>	有
	請求の範囲 _____	無

## 2. 文献及び説明 (PCT規則70.7)

文献1 : YUTAKA KOSHIBA, et al., Mitsubishi materials' high performance oxygen free copper and high performance alloys,  
SECOND INTERNATIONAL CONFERENCE ON PROCESSING MATERIALS FOR PROPERTIES, 2000, p101-104

文献2 : JP 03-079734 A (住友金属鉱山伸銅販売株式会社) 1991.04.04,  
特許請求の範囲 (ファミリーなし)

文献3 : JP 01-180975 A (田中貴金属工業株式会社) 1989.07.18,  
特許請求の範囲 (ファミリーなし)

文献4 : JP 11-236665 A (株式会社ジャパンエナジー) 1999.08.31,  
特許請求の範囲 (ファミリーなし)

文献5 : JP 2001-329362 A (株式会社日鉱マテリアルズ) 2001.11.27,  
特許請求の範囲 (ファミリーなし)

## 請求の範囲 1, 2, 4-6

請求の範囲 1, 2, 4-6 に記載された発明は、国際調査報告で引用された何れの文献にも記載されておらず、新規性及び進歩性を有する。Be:0.2~0.5wt%、を含有する低ベリリウム銅合金からなるバッキングプレート、又は、Ni:2~4wt%、Si:0.3~0.9wt%を含有するCu-Ni-Si合金からなるバッキングプレート、若しくは、Ni:2~4wt%、Si:0.3~0.9wt%を含有するCu-Ni-Si系合金からなるバッキングプレートを用いる点は、当業者といえども容易には想到し得ないことである。

PCT/JP2004/017744

日本国特許庁 10.5.2005

## 請求の範囲

[1] (補正後) マグネットロンスパッタリングに使用する銅又は銅合金ターゲット／銅合金バッキングプレート組立体であって、銅合金バッキングプレートがBc : 0. 2~0. 5 wt %含有する低ベリリウム銅合金又はNi : 2~4 wt %、Si 0. 3~0. 9 wt %を含有するCu-Ni-Si合金若しくはNi : 2~4 wt %、Si 0. 3~0. 9 wt %を含有するCu-Ni-Si系合金であることを特徴とする銅又は銅合金ターゲット／銅合金バッキングプレート組立体。

[2] Cu-Ni-Si系合金バッキングプレートにおいて、Ni : 2~4 wt %、Si 0. 3~0. 9 wt %、Cr : 0. 1~0. 9 wt %若しくはMg : 0. 1~0. 9 wt %を含有するCu-Ni-Si系合金であることを特徴とする請求項1記載の銅又は銅合金ターゲット／銅合金バッキングプレート組立体。

[3] (削除)

[4] マグネットロンスパッタリングに使用する銅又は銅合金ターゲット／銅合金バッキングプレート組立体であって、銅合金バッキングプレートが導電率35~60% (IACS)、0. 2%耐力400~850 MPaを備えていることを特徴とする請求項1又は2記載の銅又は銅合金ターゲット／銅合金バッキングプレート組立体。

[5] 拡散接合された銅又は銅合金ターゲット／銅合金バッキングプレート組立体であることを特徴とする請求項1~4のいずれかに記載の銅又は銅合金ターゲット／銅合金バッキングプレート組立体。

[6] 拡散接合温度が175~450°Cであることを特徴とする請求項5記載の銅又は銅合金ターゲット／銅合金バッキングプレート組立体。